

# 積層チップビーズアレイMZA2010シリーズ

Multilayer chip beads Array MZA2010 series

新製品

## 高密度実装の可能なチップビーズアレイ

1チップで4ラインのノイズ対策ができ、携帯機器など、より高密度な実装が要求される電子機器のI/Oラインのノイズ対策に最適です。

伝送路へ直接挿入することによりノイズ成分を除去することが可能です。

形状は2.0 x 1.0 x 0.5mmの4連ビーズであり、テーピングによる自動実装が可能なSMD部品で、リフローにも対応しています。

### 特長

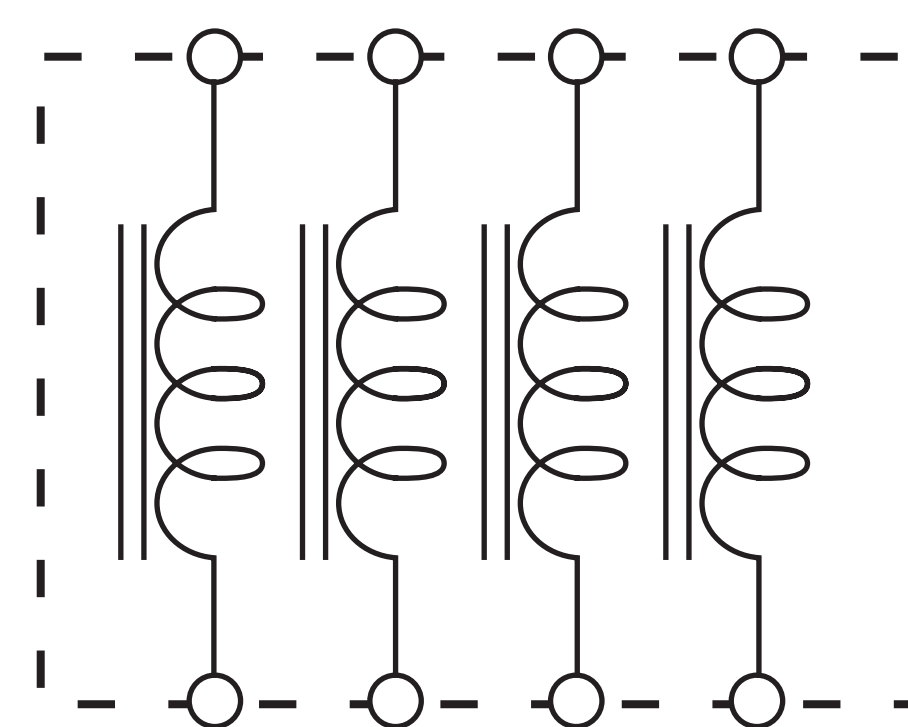
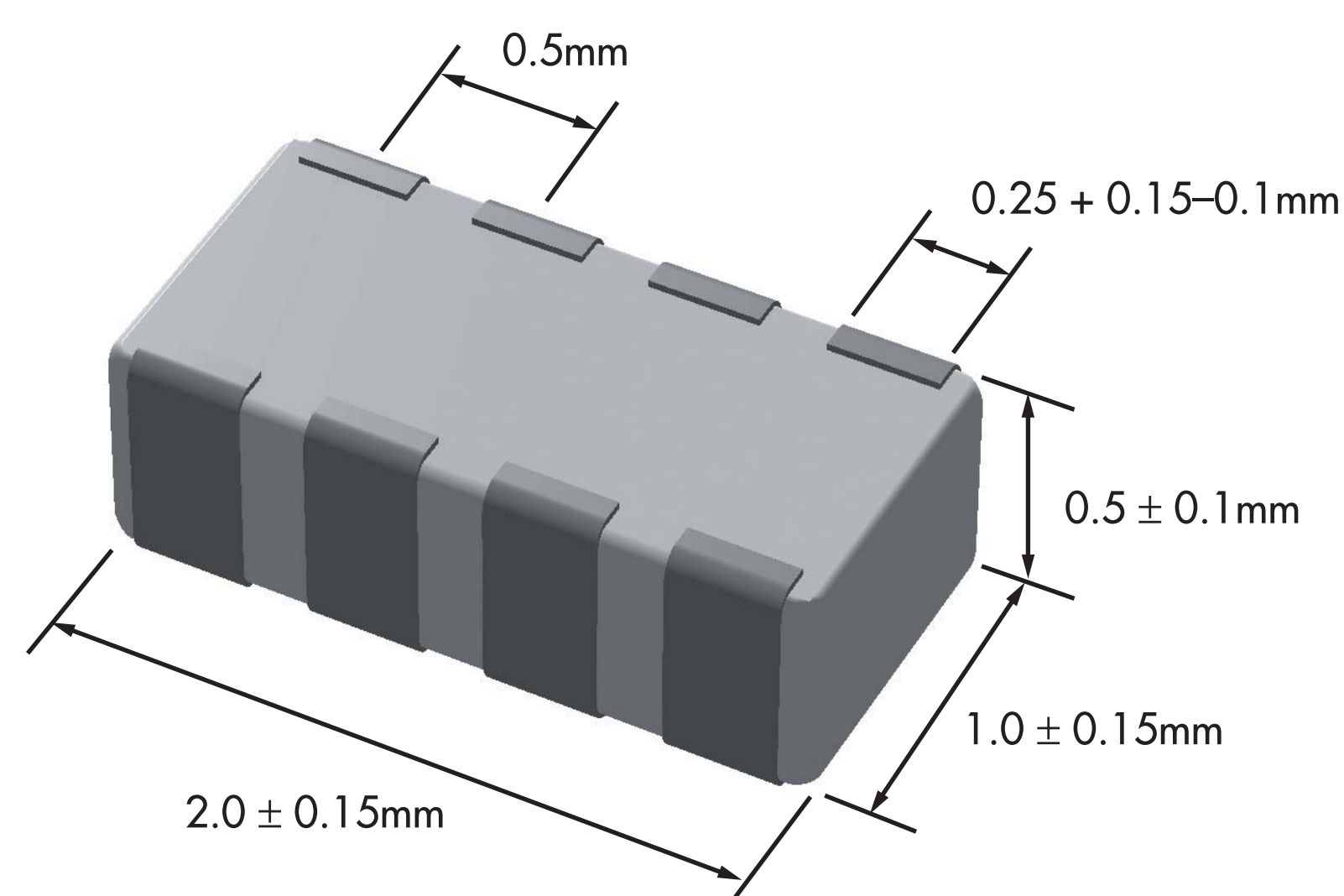
- 当社チップビーズアレイMZA3216シリーズに比し、体積比で75.6%の削減となります。
- RoHS指令対応製品。
- 隣接回路間のクロストークを低く抑えています。

### 主な用途

LCDラインなどの信号ラインのノイズ除去

### 製品仕様

ITEM	Z@100MHz [ohm] ±25%	直流抵抗 [ohm]MAX.	定格電流 [mA]MAX.
MZA2010B241C	240	0.45	100
MZA2010S800C	80	0.22	100
MZA2010S121C	120	0.25	100
MZA2010S241C	240	0.35	100
MZA2010S601C	600	0.50	100
MZA2010S102C	1000	0.75	100
MZA2010Y800C	80	0.30	100
MZA2010Y121C	120	0.40	100
MZA2010Y241C	240	0.60	100
MZA2010Y601C	600	0.80	100
MZA2010Y102C	1000	1.00	100
MZA2010D330C	33	0.30	50
MZA2010D680C	68	0.50	50
MZA2010D121C	120	0.80	50
MZA2010D241C	240	1.20	50
MZA2010F330C	33	0.60	100
MZA2010F470C	47	0.80	100
MZA2010F560C	56	0.80	100



RoHS指令対応: EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤のPBB、PBDEを使用していないことを表します。

記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。